

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 3 月 21 日(21.03.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/039181 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) B24B 37/26 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/073538
- (22) 国際出願日: 2012 年 9 月 13 日(13.09.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-201350 2011 年 9 月 15 日(15.09.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野呂 陽平 (NORO, Yohhei) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP). 奥田 良治 (OKUDA, Ryoji) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP). 福田 誠司 (FUKUDA, Seiji) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園

山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP).

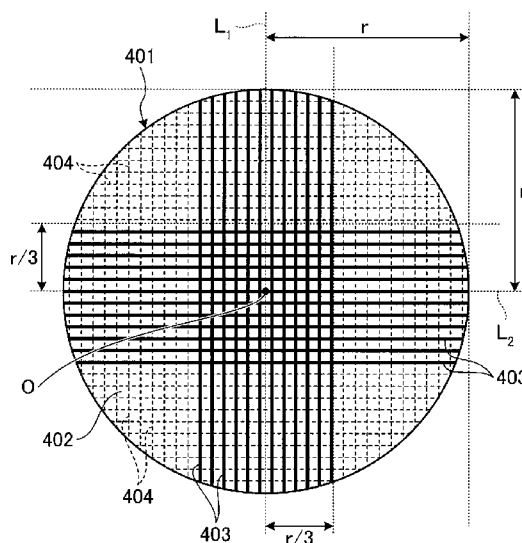
- (74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI, Hiroaki); 〒1006020 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビルディング 酒井国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド

[図4]



(57) Abstract: A polishing pad for chemical mechanical polishing having at least a polishing layer, wherein the polishing surface of the polishing layer has a first groove and a second groove, and the first and the second grooves have side surfaces that are continuous with the polishing surface at the widthwise edges of each of the grooves. In the first groove, the angle between the polishing surface and the side surface continuous with the polishing surface is 105-150° on at least one widthwise edge of the groove. In the second groove, the angle between the polishing surface and the side surface continuous with the polishing surface is 60-105° on both widthwise edges of the groove.

(57) 要約: 少なくとも研磨層を有する化学機械研磨用の研磨パッドであって、前記研磨層の研磨面に第1の溝および第2の溝を有し、前記第1および第2の溝は、それぞれの溝幅方向の縁端部に前記研磨面と連続する側面を有し、前記第1の溝は、少なくとも一方の溝幅方向の縁端部において、前記研磨面と該研磨面に連続する側面とのなす角度が105度より大きく150度以下であり、前記第2の溝は、溝幅方向の2つの縁端部の両方において、前記研磨面と該研磨面に連続する側面とのなす角度が60度以上105度以下である。

WO 2013/039181 A1



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))